

# 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:10-16:40；
- 会议召开地点：全景路演；
- 会议召开方式：网络互动交流方式。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日（星期二）15:10-16:40 期间参加“2023 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

- （一）召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:10-16:40；
- （二）召开地点：全景路演；
- （三）召开方式：网络互动交流方式。

### 三、参加人员

公司副总经理兼董事会秘书刘海龙先生（具体参会人员将根据实际情况进行

调整)。

#### **四、投资者参加方式**

投资者可在 2023 年 9 月 5 日 (星期二) 15:10-16:40, 通过互联网登录“全景路演”网站 (<http://rs.p5w.net>), 或关注微信公众号“全景财经”, 或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。公司将及时回答投资者的提问。

#### **五、联系人及咨询办法**

联系人: 公司证券事务部;

联系电话: 021-52277906;

联系传真: 022-89129719;

联系邮箱: [jhtdesign@jht-design.com](mailto:jhtdesign@jht-design.com)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日